

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-010531

(43) Date of publication of application: 14.01.1992

(51) Int. CI.

H01L 21/22

(21) Application number : **02-110182** 

(71) Applicant: TOSHIBA CERAMICS CO LTD

(22) Date of filing:

27. 04. 1990

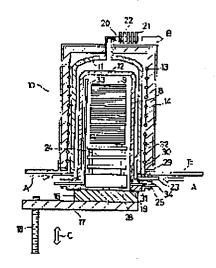
(72) Inventor: IKEGAME YOSH10

SEKIYA AKIRA SEKI AKIRA

## (54) VERTICAL DIFFUSION FURNACE

# (57) Abstract:

PURPOSE: To enable the inside of the title vertical diffusion furnace to be kept in a high purity gas atmosphere by a method wherein a processing gas leading-in pipe is provided in the vertical direction from the bottom part to the topmost part in the processing space of the diffusion furnace; the length and inner diameter of the processing gas leading-in pipe exposed in the processing space specified; and a SiC film in specific thickness is formed on the inner and outer surfaces of the leading-in pipe. CONSTITUTION: A processing gas leading-in pipe 33 is provided in a processing space 8 of a diffusion furnace 10 so as to lead-in specific processing gas. The length of the processing gas leading-in pipe 33 exposed in the processing space 8 is 1000mm-1300mm. Besides, the inner and outer diameters of the pipe 33 are almost equalized respectively to be 5-20mm and 6-20mm extending



over the whole length. Furthermore, a SiC film in thickness of 20-500µm is formed on both inner and outer surfaces by CVD(chemical vapor deposition) process. Finally, it is recommended that, as for the basic material of the processing gas leading—in pipe 33, the SiC film is formed into a high purity SiC pipe by the CVD process.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

## 19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-10531

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月14日

H 01 L 21/22

Q 2104-4M D 2104-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**ᡚ発明の名称** 縦型拡散炉

②特 願 平2-110182

②出 願 平2(1990)4月27日

@発 明 者 池 亀 良 雄 東京都新宿区西新宿 1-26-2 東芝セラミツクス株式会

社内

**⑫発 明 者 関 屋 ・ ・・ 東京都新宿区西新宿1-26-2 東芝セラミツクス株式会** 

社内

社内

⑪出 願 人 東芝セラミツクス株式 東京都新宿区西新宿1-26-2

会社

個代 理 人 弁理士 田 辺 徹

明 細・音

 発明の名称 縦型拡散炉

#### 2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は、半導体の熱処理工程に用いる

縦型拡散炉に関するものである。

## 従来の技術

従来、半導体の熱処理工程、例えば酸化、 拡散、アニール等の熱処理工程用に縦型拡散 炉が開発されていた。縦型拡散炉の特徴としては、温度分布が横型炉に比べて均一なこと、 ガスの流れが横型炉よりも良好でウェハ中の 膜厚分布精度が向上すること、Siウェバの 大口径化するに連れて横型炉での処理が困難 であること等を挙げることができる。

縦型拡散炉に使用されるライナーものは、当初は石英ガラス製のの幅射熱をであったが、石英ガラスはヒータの幅射熱をであったが、温させることから見直されつつのののでは、SiCチューブの有効性が見直されつのとでののでは、SiCチューブは高温状態のとったのは、SiCチューズは高温状態のといる。また、SiCチューズは高温状態のといるのがができる通過して処理空間を

汚ぬすることを防止する効果も持つ。

しかし、単に均熱管としてSiCチューブを用いただけでは微量の金属蒸気の侵入は防ぎされず改善が望まれていた。

そこで、本出額人は、従来技術の問題点に鑑みて、特額平1-165259号明細書において、均熱管と炉芯管の間に金属の侵入を防止するためのガスを導入でき、しかもその導入空間内を気密に保つことができる縦型拡散炉を提案した。

#### 発明が解決しようとする問題点

しかし、特願平1-165259号の拡散 炉においては、炉内に設ける処理ガス導入管 が石英ガラスで作られていたため、微量の金 属蒸気の侵入を防ぎきれないという欠点があった。

#### 発明の目的

本発明は前述のような欠点を解消して、炉

する拡散炉である。SiCの炉芯管の場合は 均熱管を必要としない。石英ガラスの炉芯管 の場合には均熱管を設けた方がよい。

#### 作用効果

処理ガス導入管の内外面に C V D により厚み 2 0 ~ 5 0 0 μ m の S i C 膜を形成したため、表面の高純度化が達成され、それに伴って、炉内の処理空間も高純度化が図れる。

#### 実 施 例

以下、図面を参照して本発明による縦型拡散炉の実施例を説明する。

第1 図は縦型拡散炉10を示す概略図である。縦型拡散炉10は全体的に円筒形状の炉芯管12(反応管又はプロセスチューブとも呼ばれる)を備えている。炉芯管12は下方に開口していて、その開口から半導体ウエハ9を出し入れする構成になっている。炉芯管12は石英ガラスで構成してあり、その内部

内をより高純度のガス雰囲気に保持できるようにする縦型拡散炉を提供することを目的と している。

#### 発明の要旨

前述の目的を達成するために、この発明は 請求項 1 に記載の凝型拡散炉を要旨としてい る。

#### 問題点を解決するための手段

が処理空間 8 を形成している。処理空間 8 にはウエハ保持部材 2 8 によって多数の半導体ウエハ 9 が設置してある。

処理空間内には処理ガス導入管33が設けてあり、所定の処理用ガスを導入できる構成になっている。同様に処理ガス排出管34が設けてあり、処理用のガスを排出する構成になっている。

処理ガス導入管3 3 は処理空間に露出した部分の長さが1 0 0 0 ~ 1 3 0 0 mmである。図示例では、この長さは1 1 0 0 mmになっている。また、処理ガス導入管3 3 の内径と外径は全長にわたってほぼ均一になっており、4 径は5 ~ 2 0 mmであり、外径は6 ~ 2 2 mmである。図示例では、内径は1 2 mmになっており、外径は1 6 mmになっている。

さらに、処理ガス導入管33の内面と外面には、CVD(化学蒸着)によりSiC膜が

形成してある。 S i C 膜の厚みは 2 0 ~ 5 0 0 μ m であるが、最高の効果を得るには 5 0 ~ 1 0 0 μ m にするのが好ましい。

CVDによるSiC膜の形成法の最適例は焼抜き法である。たとえば、炭素棒又は管の外面にSiC膜を形成した後に炭素棒又は管を焼抜き、SiC管を得る。

なお、処理ガス導入管33の基材はCVDによるSiC膜の成形による高純度なSiC 管にするのが好ましい。

ウェハ保持部材28は複数の遮熱板24を持つ。また、保持したウェハる。ウェハ保持部材28は炉蓋16に設置してあり、炉蓋16はベース17に固定してある。ベース17の一端にはナット(図示せず)が固定しいる。ナットは送りねじ18とかみ合っている。

方向(矢印 C) に送られる。このように送り ねじ 1 8 を回転することによりウエハの移動 を行う。なお、送りねじは 1 本、ガイドシャ フトが 1 本設けてあり、第 1 図ではガイドシャフト 1 本は前の送りねじの後ろに位置して

均熱管11はSiCまたはSi含浸のSICで構成する。耐酸化性、ガス透過性等を考慮するとSi含浸のSiCが望ましい。

均熱管 1 1 の上部には、排気管 2 0 が設けてある。排気管 2 0 の端部にはフランジ 2 1 が設けてある。このフランジ 2 1 にテフロン製の 0 リングを介してガス管(図示せず)を接続できる。排気管 2 0 の外側には多数の冷却フィン 2 2 が設置されている。

均熱管 1 1 の下端部外周部にはステンレス製の架台 1 5 が設けてある。

集台15の下にはステンレス製の部材29 がネジ止めされ設置してある。部材29の上 には均無管11が設置され、均無管11と部 材29の接触部分にはテフロン製の0リング 30が設けてあり、炉の気密性を高めている。 部材29にはガス導入手段としてガス導入管 23が設置してあり、炉芯管と均無管の間の 空間26にガスを導入する構成になっている (矢印A)。この実施例ではガス導入管23 が対向する2ヶ所に設けてある。ガス導入管 23によって導入されたガス、例えば塩酸ガスを含んだ窒素ガスは均熱管11上部に設け た排気管20からガス管(図示せず)を通し て排出される(矢印B)。

部材 2 9 と炉蓋 1 6 の間には、ステンレス製の部材 2 5 が配置してあり部材 2 9 にネジ止めされている。部材 2 9 と部材 2 5 の間、部材 2 5 と炉蓋 1 6 の間にはテフロン製の 0 リング 3 1、19 が設けてあり、炉の気密性を高めている。

部材 2 5 の上には、 炉芯管 1 2 が設置され 炉芯管 1 2 と部材 2 5 の接触部分にはテフロン製の 0 リング 3 1 が設けてある。 炉芯管の み交換する場合には、 部材 2 5 を部材 2 9 に 止めているネジをとり、 炉蓋 1 6 とともに下 方へ移動させることにより交換できる。

架台15、部材29、部材25、及び炉蓋 16は中空にして、冷却する構造にしてもよい。

均熟管 1 1 の外側にはヒータ 1 3 が配限されている。ヒータ 1 3 の外側には例えば断熱ファイバからなる断熱体 1 4 が形成してある。ガス流量は使用する条件によって調節できる。

ガスを含んだをまかった。 酸化処理を行った場合のシリカ合との を変えたり、この をでいる。 をでいる。

23…ガス導入手段

20…ガス排気管

22…放熟フィン

代 理 人 弁理士 田 辺 御



きることが明らかになった。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による報型拡散炉の実施例を示す概略図、第2 図は第1 図に示したがにおいてウエハの出入れのために炉蓋やベースを下方に移動したところを示す概略図である。

10…級型拡散炉

1 2 … 炉芯管

1 1 … 均熱管

13…ヒータ

1 4 … 断熱体

第 1 表

	Na含有量	Ni含有量
	atms/cm²	atms/сm²
ガス流量 5 ℓ ✓ nin	0.3×10°以下	0.3×10°以下
ガス流量 O & /nin	5 × 1 0 °	2×10°

#### 第 2 表

サンプル	排気管フランジ
:	端面温度(℃)
フィン付きガス排気管	150
フィン無し	372

Fig. 1

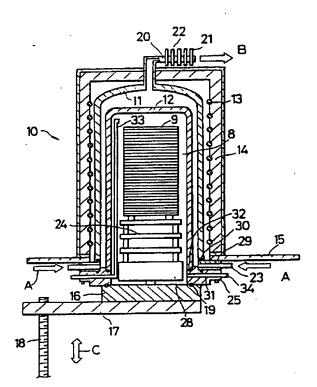


Fig. 2

